

精測於台灣半導體展 展出多款高階探針卡與衛星大型通訊板

發佈單位：中華精測科技股份有限公司 (股票代號: 6510 攤位: I-2300)

發佈日期：2018/09/04

精測身為全球手機應用處理器(AP)測試板之領導廠商，充分瞭解 AI、5G 的應用發展，將引爆 AP、記憶體(Memory)、特殊應用晶片(ASIC)、整合型觸控驅動晶片(TDDI)、射頻晶片(RFIC)、電源管理晶片(PMIC)等產品的放量成長，其所需之晶圓測試探針卡商機，亦將因應而生。精測掌握此商機，將於台灣半導體展中展出相關應用的高階探針卡。

精測總經理黃水可表示，手機 AP 晶片仍是驅動先進製程的重要推手，精測備妥高達 4 萬針數(pin count)探針卡的技術與產品，以滿足客戶手機 AP 內建 AI 及更多新功能所需的高腳數(high pin count)需求。

當先進封裝技術演進，記憶體的 KGD(Known Good Die)需求便隨之提升，於是在晶圓測試階段，便產生高速測試的大量需求，其對電性要求更加嚴謹，此為精測所專精領域，因而受到記憶體廠商青睞，取得 LPDDR4 探針卡驗證機會。

另一方面，人工智慧及區塊鏈技術應用所衍生的商機，將帶動更多 ASIC 需求，精測 All in House、快速反應的營運模式，可以滿足客戶的急單需求，領先推出新產品搶進市場，因而成為 ASIC 客戶評估探針卡廠商的首選。

精測研發生產 50um 微間距的探針卡，可滿足 TDDI 及高階影像處理晶片的測試需求，其相對強固的結構及可提供高速訊號測試的能力，將可提升客戶的量產效率，將有機會取代現有 TDDI 測試方案。

5G 的主流頻段為 Sub-6GHz 及 28GHz，不同於傳統分段式線路設計，精測運用橫跨材料、機構、熱學、電學...等完整的研發環境，對探針卡全路徑進行模擬分析與量測驗證，以提供最佳的毫米波(mmWave)高頻傳輸測試方案，滿足客戶對 RFIC 探針卡的需求。

隨著 IC 功能複雜化以及對低功耗的需求日益增加，電源管理晶片(PMIC)將肩負更多不同電壓的需求，以及提供更精準的電壓位準，精測具備足以提供客戶更優質的 PMIC 晶圓探針卡及 IC 測試板。

精測除因垂直整合而邁入探針卡領域，同時也積極跨出 AP 市場範疇，甚至取得國際航太公司衛星電路板策略合作商機，預計 2019 年小量生產，2020 年量產並具體貢獻營收。因應營運擴大與產能需求，精測將於桃園新建營運總部，耗資新台幣 16.5 億元，新總部樓板面積為目前總部兩倍大，預計於 2019 年第三季啟用，持續為半導體與衛星通訊產業，提供服務。